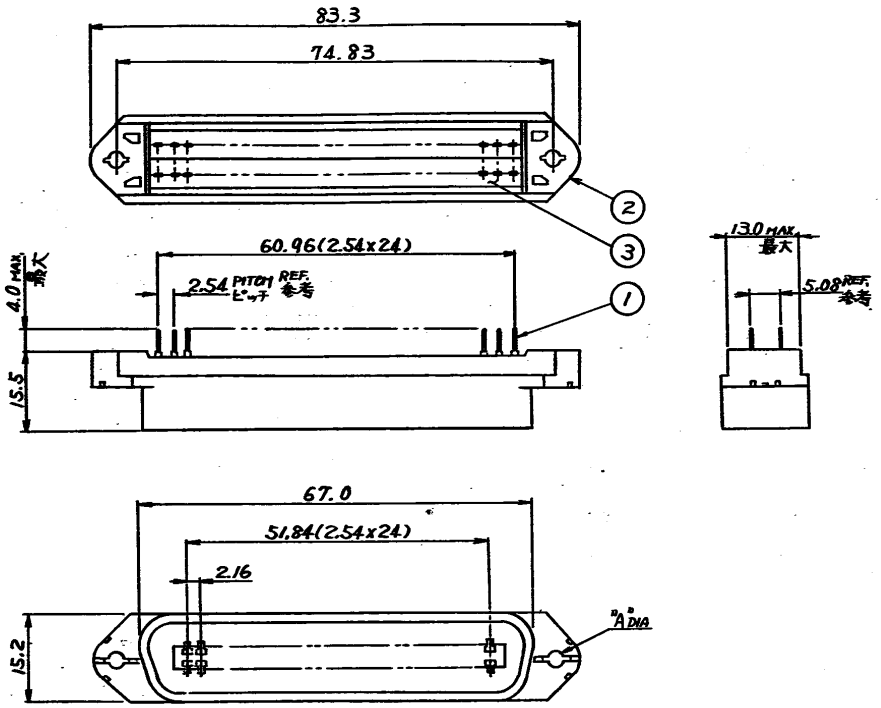
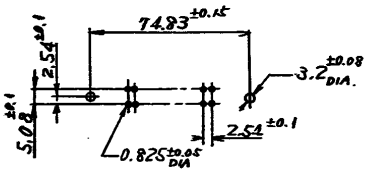
三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)





推奨基板寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD DIMENSION.

注記

⚠ メッキ仕様：コンタクト接触部：1.3μMIN.のニッケル下地メッキの上に 0.76μMIN. の金メッキ
アクション部：1.3μMIN.のニッケル下地メッキの上に 2.5μMAXの半田メッキ

NOTE

⚠ FINISH CONTACT AREA: 1.3μMIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μMIN. GOLD PL.
ACTION AREA: 1.3μMIN. NICKEL UNDER. PL. 2.5μMAX. TIN-LEAD PL.

2.65	↑ -2	↑	ベース ハウジング BASE HOUSING	3
3.2	174158 -1	熱可塑性樹脂 THERMOPLASTIC	カバー ハウジング COVER HOUSING	2
"A" DIA	型番 P/N	銅合金 COPPER ALLOY	コンタクト CONTACT	1
		材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM No.

LTR	改訂 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
0	ME 作成 12361	T.S.		3/20/90

© 1990 年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 1990 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

被覆外径範囲 (WIRE RANGE)	— AWG ( )
絶縁体径 (INSULATION DIA.)	—
材料 (MATERIAL)	表示参照 SEE TABLE
仕上 (FINISH)	注記⚠参照 SEE NOTE ⚠
名称 (NAME)	SOP CHAMP V PLUG ASS'Y ACTION PIN TYPE
一般公差	MILL. ±0.2 / MACH. ±0.25 / MOLD. ±0.3 / 角度 ±5°
SIZE	B
LOC	J
番号 (NO.)	C-174158
DR.	T. Sasaki 3/20/90
CHK	T. Sasaki
DE	T. Sasaki 3/20/90
APP	Yoichi Dai
RIE (SCALE)	—
REV.	0
SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PART DIST

本紙：特 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT Proj. No. 65F-017

AMP-J 030-2 REV. 9/83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor